

|  |
| --- |
| [삼성전자] System LSI사업부 박사 채용 공고 |

삼성전자 System LSI 사업부는 스마트폰, 태블릿 PC 등 IT기기의 핵심 부품인

시스템 반도체를 개발 및 양산하고 있습니다.

시스템 반도체는 자동차, IoT, 바이오, 헬스케어 등으로 활용분야가 더욱 확대될

것이며, 우리가 새로운 세상에 한발 더 가까워질 수 있게 할 것입니다.

대한민국과 삼성전자의 신 성장 동력인 시스템 반도체의 미래를 이끌어 갈

훌륭한 인재를 모시고자 하오니 많은 관심 부탁 드립니다.

**□ 지원자격 및 절차**

|  |  |
| --- | --- |
| **지원자격** | **2016년 8월 박사 졸업 예정자 (2017년 졸업 예정 및 기 졸업자 가능)** |
| **사업분야**  **및**  **모집부문** | **□ SOC**  - Modem System, Modem Protocol, RF, AP, Architecture, Software  **□ LSI**  **-** CMOS Image Sensor, Display Driver IC, 지문인식 IC, PMIC,  M-healthcare, LSI Technology Development  **□ 기반설계**  - Design Technology, Mixed Signal Core, Digital IP, ESD, TCAD  **□ Foundry**  - Process Architecture  **□ 기타**  - 제조기술, YE, 품질 |
| **근무지** | 삼성전자 기흥/화성사업장 |
| **전형절차** | 서류전형 → 전화인터뷰 → 기술면접 → 인사면접 → 건강검진 |
| **지원서접수** | **상시 접수 (recruit.lsi@samsung.com)** |
| **문의처** | 전화(031-209-6556), 메일(recruit.lsi@samsung.com) |

**□ 모집분야**

|  |  |
| --- | --- |
| **구 분** | **상세분야** |
| **SOC** | **□ Modem System**  - RF IC와 Baseband 제어블록(Filter, AGC, AFC, PN Model) 설계,  Connectivity 알고리즘  **□ Modem Protocol**  - 3GPP 표준 SW 개발 경험자  **□ RF**  - Cellular/Connectivity RF 전문가  **□ Application Processor**  - IP 설계전문가  (Connectivity, Modem H/W, Audio, Multimedia, High Speed Serdes)  - DFT, Debug, Verification, PI/SI, Reference Board 설계  **□ Architecture**  - ModAP, Multimedia, Power, Connectivity 분야  **□ Software**  - Embedded OS, Compiler, Telephony, SQE, Audio, Camera, GNSS |
| **LSI** | **□ CMOS Image Sensor**  - Sensor Analog 설계전문가(CDS/DBS 등), ISP, Lens, Module, 평가, 튜닝  **□ Display Driver IC**  - Logic 설계(I/F, T-Con, Low Power)  - Analog설계  (LDO, 소스 감마/채널I, DC-DC Converter, Regulator, Noise 제거, 고속 I/F)  - Touch 설계(TSP, Analog 설계) 및 FAE  **□ 지문인식 IC**  - 지문인식 S/W 및 H/W 개발  **□ PMIC**  - Architect  - Analog설계  (Multi-Phase Switching regulator, DC-DC Converter, Battery 관리시스템)  **□ M-Healthcare**  - 생체신호 센싱 알고리즘, 저전력/고효율 Digital 회로 설계  **□ LSI Technology Development**  - CMOS Image 센서 공정, CMOS Pixel 소자 전문가  - HV Analog Device |
| **기반설계** | **□ Design Technology**  - Library, DFT, PD/Low Power(STA/Leakage 해석/최적화),  Timing(Clock Mesh 해석/최적화)  - In-House Tool개발, EMI/RFI/Mixed SI, FPGA/Emulator, 검증(Formal)  **□ Mixed Signal Core**  - High-Speed SAR ADC, TDC/PLL Low Power IP, High Accurate/Digitalized  Temperature Sensor, Regulator/Buck/Charger  **□ Digital IP**  - Security(PUF IP), LINK(Uni Pro), PHY(10Gbps, 4Gbps DRAM I/F), Validation  **□ ESD, TCAD**  - 공정에 대한 ESD 특성분석 및 개선을 위한 ESD/TCAD 동시 경험 |
| **Foundry** | **□ Process Architecture**  - Advanced Logic 공정의 BEOL Integration 및 Reliability 전문가  - GRV(Ground Rule Verification), DFM 및 Process Control 기술 경험자  - RF Device Evaluation 및 Characterization 전문 기술 확보, RF CMOS 및  Mixed Signal 소자 기술 확보 |
| **기 타** | **□ 기술**  - Photo(Overlay, Aerodynamic Electromagnetic simulation)  - Etch(Simulation, Module)  - CMP(Defect 제어, Material 개발 경험)  - Clean(Cu Void 제어, Clean COR설비 식각산포 개선, Defect제어)  - Diffusion(HKMG, SiGe)  - CVD(Low K Film 두께 산포 및 Defect 제어)  - Metal(ALD 공정 두께 산포 Control 및 Defect 제어)  **□ YE**  - Metrology(New Material & Process Metrology Solution 개발)  - 분석(SEM, TEM, STEM, EELS, APT)  - 소재(Package, Wafer, Chemical)  - Device & Process(Transistor 특성확보, 불량분석)  - Defect, eSiGe, EPI  **□ 품질**  - 10nm 공정노드에서의 SER평가, SER모델링 및 벤치마킹  - Circuit Reliability, TEG design 및 신뢰성 모델링  - 소자 Reliability CAD  - Flexible Package electronics  - Excursion/Claim주요이슈 대응을 위한 표면 분석 |